

のせる つなぐ つくる そして ひろげる



# 電子機器2022 トータルソリューション展

東京ビッグサイト 東2-6ホール

6.15 Wed. → 6.17 Fri.

## 『 JPCA Show 2022 』 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

当社は来る 2022年6月15日(水)～17日(金)に東京ビッグサイトにて開催される『電子機器トータルソリューション展』へ出展する運びとなりました。

本展では、電子部品の「**真贋調査**」を新しいサービスとして、ご紹介を予定しております。

**真贋調査サービスとは**、世界的な半導体・電子部品の不足が長期化する中、通常とは異なる部品調達による、流通在庫品の品質確認や模倣品対策が問題視されてる中、**お客様が調達された製品をお預かりし、正規品(良品)と調査品(模倣品)を比較調査(非破壊・破壊)し、検証を受け賜わります。**

また、その他、ISO/IEC17025 試験所認定、高性能 X 線 CT 観察のご紹介を致します。

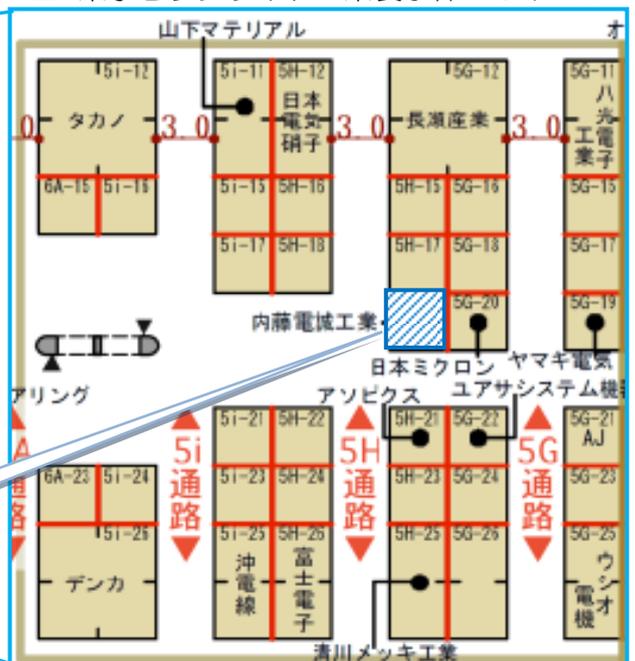
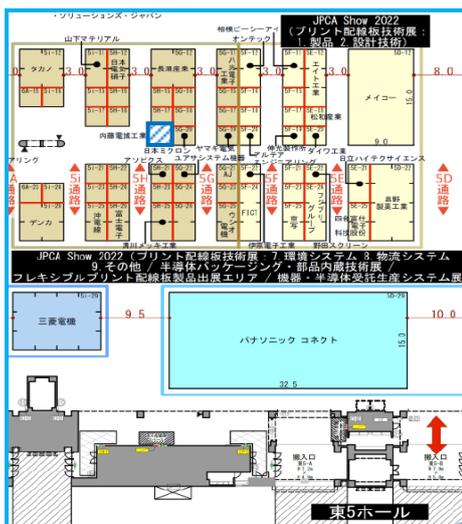
つきましては、ご多用中のところ恐縮ではございますが、当社ブース(小間番号:5H-19)にお越し頂き、技術・サービスをご高覧賜りたく、ご案内申し上げます。ご来場を心よりお待ちしております。

敬具

会 期 : 2022年6月15日(水)～17日(金)  
会 場 : 東京ビッグサイト 東5ホール  
ブース番号 : 5H-19

### ■ 東京ビッグサイト 東展示棟 5ホール

#### 【ブース位置】



内藤電誠工業株式会社

東5ホール 5H-19

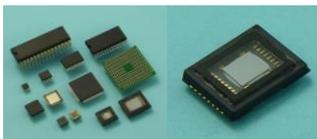
裏面 【出展製品・サービス 一例】を紹介

## ● IC開発ターンキーサービス

カスタム IC をご検討のお客様に、少量多品種の IC、LSI のターンキーサービスを提供しています。複数の国内外ファウンドリを使用できることから、お客様のご要求に最適なプロセスを提案いたします。ご要求数量やご予算に応じて MPW(Multi Project Wafer)、MLM(Multi Layer Mask)、フルマスクといった製造方法が選択でき、試作から量産対応まで承っております。



## ●半導体パッケージング サービス



試作、少量品から量産品まで、車載品にも対応した国内自社工場で、半導体パッケージの製造受託サービスを提供いたします。

- QFN、QFP、SOP系、DIP系、BGA などのパッケージング
- 光学センサやMEMSセンサなどに適した各種 中空パッケージ技術
- ダイシングやバーンインテストなど製造工程の一部やスクリーニングなど標準外作業

## ●信頼性評価・調査解析の受託サービス



各種信頼性試験・評価～調査解析まで一貫受託サービスで品質向上をサポートいたします。

- ISO/IEC17025 試験所認定を取得し、国際標準規格での認定試験に対応可能です。  
信頼性評価：各種環境試験(TC, HT, HHT, HHBT, PCT など)、連続モニタ、リフロー耐熱性試験、染色評価、熱抵抗測定
- 業界トップクラスのX線CT装置でX線透過やCT観察で内部欠陥を可視化します。  
物理解析：顕微鏡観察、X線CT観察、SAT観察、PKG開封、SEM/EDX、断面加工、レーザー開封、ボンダブル・シェア強度試験、PIND試験
- 真贋調査：お客様が調達された製品(IC)をお預かりし、正規品(良品)と  
**New** 調査品(模倣品)の比較調査(非破壊・破壊)の検証を行います。

他にも多数の製品や保有技術、サービスの紹介を用意してお待ちしております。



## 内藤電誠工業株式会社

評価解析業部 営業管理部

Tel. 044-811-5496 Fax. 044-850-5851

E-mail ndkz-hyouka@ndk-grp.jp

URL <https://www.lab.ndk-grp.co.jp/>